

证券代码：688484

证券简称：南芯科技

公告编号：2026-018

上海南芯半导体科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 21 日出具的《关于同意上海南芯半导体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕365 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 6,353.00 万股，每股发行价格为人民币 39.99 元，募集资金总额为人民币 254,056.47 万元，扣除发行费用人民币 16,572.76 万元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币 237,483.71 万元，上述资金已全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《上海南芯半导体科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2023]230Z0068 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

发行名称	2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023 年 3 月 30 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额（元）
一、募集资金总额	2,540,564,700.00
其中：超募资金金额	716,842,301.69
减：直接支付发行费用	165,727,598.31
二、募集资金净额	2,374,837,101.69
减：	
以前年度已使用金额	712,042,950.66
本年度使用金额	430,709,907.42
实际使用补充流动性资金	750,606,126.54
现金管理金额	510,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	19,390.84
加：	
募集资金利息收入	45,678,867.84
募集资金专用账户获取的理财收入	11,309,092.31
三、报告期末募集资金余额	28,446,686.38

二、募集资金管理与存放情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司对募集资金实行专户存储。公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海南芯半导体科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议及专户存储情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，本公司已与保荐人中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议，具体情况详见公司于2023年4月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南芯科技首次公开发行股票科创板上市公告书》以及公司于2025年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。（公告编号：2025-038）。

报告期内，公司对已经按照规定使用完毕的募集资金账户进行了注销，详见公司分别于2025年5月21日和2025年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-039，2025-042）。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2025年12月31日，上述三方监管协议均正常履行。

截至2025年12月31日，公司首次公开发行募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801300004414	175.77
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801700005811	14,448,398.37
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801500005812	5,164,668.84
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801500004413	已注销
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801100004415	已注销
中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201013501588062	1,717.26
招商银行股份有限公司上海分行营业部	571922593810008	8,831,726.14
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121936870310608	—
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121936870310855	已注销
交通银行股份有限公司上海张江支行	310066865013006606294	已注销
上海银行股份有限公司浦东分行	03005244551	已注销
兴业银行股份有限公司上海大柏树支行	216380100100371052	已注销
上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行	50131000935063329	已注销
合计	—	28,446,686.38

截至2025年12月31日，募集资金购入理财余额情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	余 额
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801700005811	250,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801500005812	180,000,000.00
招商银行股份有限公司上海分行营业部	571922593810008	80,000,000.00
合 计	—	510,000,000.00

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目的预先投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况

为提高募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于 2025 年 7 月 31 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 7 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。该决议自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海南芯半导体科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-048）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已使用暂时闲置资金购买理财产品 51,000.00 万元。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司不存在募集资金节余的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025 年 2 月 28 日，公司召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目、使用超募资金追加投资额以实施募投项目的议案》，并经 2025 年 3 月 25 日召开的公司 2025 年第一次临时股东会审议通过同意公司将原募投项目“测试中心建设项目”，变更为“芯片测试产业园建设项目”，实施主体为浙江南芯半导体有限公司，项目总投资 144,250.24 万元，分两期进行建设，一期投入 71,287.30 万元，二期投入 72,962.94 万元。

“测试中心建设项目”变更主要是基于对市场和行业发展趋势的把握，为满足公司发展战略的规划，将“测试中心建设项目”变更成“芯片测试产业园建设项目”，能够为公司研发和生产国产芯片提供基础保障；通过芯片测试研发和生产的一体化，提高公司产品测试技术能力；能够更有效地控制产品质量，提高生产效率，降低不良率和售后服务成本，提升公司产品质量管理水平；同时自主可控的测试产线有利于保障公司产品稳定供应，有利于公司降低产品测试成本；能够提升公司的核心竞争力，支持公司经营规模的提升，尤其是车规业务规模的发展，符合公司长期发展战略。因此，公司将原“测试中心建设项目”，变更为“芯片测试产业园建设项目”，实际变更募集资金 27,323.64 万元及其孳息 1,036.21 万元用于“芯片测试产业园建设项目”，同时实际使用剩余超募资金 29,684.23 万元及其孳息 1,687.01 万元增加投资额，合计实际使用募集资金 57,007.87 万元及其孳息 2,723.22 万元用于“芯片测试产业园建设项目”一期投资。其余所需资金由公司自有资金、自筹资金补足。变更募集资金金额为 57,007.87 万元，占募集资金总额的比例 24.00%。

2025年3月4日，保荐人中信建投证券股份有限公司对上述事项发表核查意见，同意上述事项。

变更情况详见附表2：《2025年度变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。本报告期内，因公司财务人员误操作，将募集资金专户资金误作为一般户支付，公司及时发现并追回款项；该笔操作未影响募集资金存放与使用，后续公司将加强日常管理，避免类似情况发生。除上述事项外，不存在违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司截至报告期末募集资金的存放与实际使用情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了南芯科技2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人认为：公司2025年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。除因公司财务人员误操作，将募集资金专户资金误作为一般户支付，公司及时发现并追回款项的情

况外，公司不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

附表 1:

2025 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				237,483.71		本年度投入募集资金总额				43,070.99			
变更用途的募集资金总额				57,007.87		已累计投入募集资金总额				189,335.90			
变更用途的募集资金总额比例				24.00%									
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
高性能充电管理和电池管理芯片研发和产业化项目	无	45,686.45	45,686.45	45,686.45	10,033.68	46,632.71	946.26	102.07	2025 年 12 月	不适用	不适用	否	
高集成度 AC-DC 芯片组研发和产业化项目	无	22,717.78	22,717.78	22,717.78	8,546.06	23,320.11	602.33	102.65	2025 年 12 月	不适用	不适用	否	
汽车电子芯片研发和产业化项目	无	33,484.43	33,484.43	33,484.43	18,025.31	34,403.28	918.85	102.74	2025 年 12 月	不适用	不适用	否	
测试中心建设项目	是	30,910.82	3,587.18	3,587.18	133.93	3,587.18	—	100.00	2025 年 12 月	不适用	不适用	否	
芯片测试产业园	是	—	27,323.64	27,323.64	6,332.01	6,332.01	-20,991.63	23.17	2031 年 2 月	不适用	不适用	否	

建设项目												
补充流动资金	无	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	33,060.61	60.61	100.18	不适用	不适用	不适用	否
承诺项目小计	—	165,799.48	165,799.48	165,799.48	43,070.99	147,335.90	-18,463.58	88.86	—	—	—	—
超募资金投向												
超募资金永久补充流动资金	—	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金用于芯片测试产业园建设项目一期	—	29,684.23	29,684.23	29,684.23	0.00	0.00	-29,684.23	—	2031年2月	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	—	71,684.23	71,684.23	71,684.23	0.00	42,000.00	-29,684.23	—	—	—	—	—
合计	—	237,483.71	237,483.71	237,483.71	43,070.99	189,335.90	-48,147.81	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见“四、变更募投项目的资金使用情况”											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、本报告期募集资金实际使用情况（四）”											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

注 1：募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。

注 2：本报告中若部分合计数与单项数据之和在尾数上存在差异，均为四舍五入原因所致。

附表 2:

2025 年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
芯片测试产业园建设项目	测试中心建设项目	57,007.87	57,007.87	6,332.01	6,332.01	11.11	2031 年 2 月	不适用	不适用	否
合计	—	57,007.87	57,007.87	6,332.01	6,332.01	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)	详见“四、变更募投项目的资金使用情况”									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									